

首 页 成果 | 机构 | 登记 | 资讯 | 政策 | 统计 | 会展 | 我要技术 | 项目招商 | 广泛合作

科技频道 节能减排 | 海洋技术 | 环境保护 | 新药研发 | 新能源 | 新材料 | 现代农业 | 生物技术 | 军民两用 | IT技术

国科社区 博客 | 技术成果 | 学术论文 | 行业观察 | 科研心得 | 资料共享 | 时事评论 | 专题聚焦 | 国科论坛



国防科工 | 航空航天 | 计算机与网络 | 汽车与车辆 | 船艇 | 新材料与新工艺 | 能源与环保 | 光机电 | 通信
专题资讯

当前位置：科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 贴片超亮纯白色半导体发光灯

请输入查询关键词

科技频道

搜索

贴片超亮纯白色半导体发光灯

关 键 词：贴片 半导体发光灯

所属年份：2006

成果类型：应用技术

所处阶段：成熟应用阶段

成果体现形式：新工艺

知识产权形式：

项目合作方式：其他

成果完成单位：厦门市光莆电子有限公司

成果摘要：

该产品采用380~420mm的紫光LED芯片激发荧光粉制成白光，柔性电路板采用的贴片封装技术，实现产品的小型化高亮度。该产品光强超过700mcd，超过合同指标320mcd，最小体积0.3mm，产品基板厚度达到0.05mm，而日亚公司产品的基板厚度为0.1mm。在产品厚度与日亚相同时，塑封的环氧体高，产品聚光效果好，产品的光强高。该项目的主要创新点有，采用380~420mm的紫外线半导体芯片作为白光的激发源替代原来蓝光作为激发源的工艺，提高了发光效率；采用贴片封装技术替代原直插式的封装技术，使产品具有体积小，高可靠性的优点。该产品可广泛运用于手机、PDA、LCD显示器、照相机及军工产品等、照明、路灯、信息显示屏、汽车照明、指示产品上等。

成果完成人：汤晓慧;林瑞梅;曹建泽;许志平;徐海燕;林玉仙

[完整信息](#)

行业资讯

- 管道环氧粉末静电喷涂内涂层...
- 加氢处理新工艺生产抗析气变...
- 超级电容器电极用多孔炭材料...
- 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的...
- 库尔勒香梨排管式冷库节能技...
- 高温蒸汽管线反射膜保温技术...
- 应用SuperIV型塔盘、压缩机注...
- 非临氯重整异构化催化剂在清...
- 利用含钴尾渣生产电积钴新工艺
- 引进PTA生产线机械密封系统的...

成果交流

推荐成果

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| · 新型稀土功能材料 | 04-23 |
| · 低温风洞 | 04-23 |
| · 大型构件机器缝合复合材料的研制 | 04-23 |
| · 异型三维编织增减纱理论研究 | 04-23 |
| · 飞机炭刹车盘粘结修复技术研究 | 04-23 |
| · 直升飞机起动用高能量密封免... | 04-23 |
| · 天津滨海国际机场预应力混凝... | 04-23 |
| · 天津滨海国际机场30000立方米... | 04-23 |
| · 高性能高分子多层复合材料 | 04-23 |

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号